



台積公司2024年供應鏈管理論壇頒發優良供應商獎項

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2024/12/2

台灣積體電路製造股份有限公司今（2）日舉辦 2024 年供應鏈管理論壇，並頒發當年度優良供應商獎項。論壇中，台積公司首先感謝供應商夥伴過去一年的貢獻，深化台積公司技術領先地位，以及拓展全球生產布局，再一次共同成就卓越，為全球客戶釋放創新能量。

本屆論壇以「賦能未來—打造永續半導體生態系」為題邀請主題講者，包括國際永續領域巨擘、氣候及平等倡議者 Paul Polman 分享將永續結合商業策略的洞見，並由專精於運用人工智慧與數據分析優化流程、實現減碳目標的默克集團技術長 John Langan 剖析綠色科技革命。同時，論壇規劃涵蓋先進封裝、材料科技，以及職場性別賦能等多元的分組討論，激盪創新與對話，為供應鏈韌性挹注成長動能。

台積公司董事長暨總裁魏哲家博士表示：「半導體生態系和全球供應鏈不只是台積公司成功的關鍵，更是塑造未來科技的重要角色。我們除了持續提升策略規劃、增強產能、加強韌性並提升品質，更有責任確保我們的行動對永續發展和經濟帶來正向的價值。透過創新和技術合作，讓我們一起創造一個共好的未來。」

台積公司資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士表示：「隨著全球對半導體的需求不斷增加，我們要仰賴上下一心的供應鏈，共同迎向未來的挑戰並掌握良機。衷心地感謝所有合作夥伴在過去一年的努力，支持台積公司持續成長，特別是先進封裝等製程技術的及時擴充。我們期待與各位持續攜手向前、邁向雙贏。」

台積公司董事長暨總裁魏哲家博士及資深副總經理暨副共同營運長侯永清博士於活動頒發 2024 年優良供應商獎項，表彰在創新、技術合作、支援全球量產、綠色製造、系統自動化與建廠管理等方面表現卓越之供應商，感謝其專業服務，帶動供應鏈與相關產業不斷升級。

2024 年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下（按英文名稱字母排序）：

- 應用材料股份有限公司—卓越技術合作
- 旭化成株式會社—先進封裝卓越技術合作與量產支援
- ASM台灣先藝科技股份有限公司—卓越量產支援
- 艾司摩爾科技股份有限公司—卓越量產支援
- 佳能股份有限公司—先進封裝卓越量產支援
- 達欣工程股份有限公司—新廠建置表現卓越
- 迪思科高科技股份有限公司—先進封裝卓越量產支援
- 信銘工業股份有限公司—卓越量產支援



- JX金屬株式會社－卓越技術合作與量產支援
- 美商科磊股份有限公司－卓越技術合作與量產支援
- 科林研發股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越技術合作與量產支援
- 李長榮集團－綠色製造卓越貢獻
- 村田機械株式會社－晶圓廠自動化表現卓越
- 納美仕株式會社－先進封裝卓越技術合作與量產支援
- 紐富來科技股份有限公司－傑出光罩刻寫技術合作
- 奧璐佳璫科技－新廠建置表現卓越
- 辛耘企業股份有限公司－先進封裝卓越量產支援
- 台灣迪恩士半導體科技股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援
- 芝浦先進科技股份有限公司－先進封裝卓越量產支援
- 信越化學工業株式會社－卓越量產支援
- 株式會社SUMCO－卓越量產支援
- 特諾本科技有限公司－卓越量產支援
- 東京威力科創股份有限公司－卓越技術合作與量產支援
- 日本東京応化工業株式會社－創新技術合作
- 崇越石英製造廠股份有限公司－卓越量產支援
- 東鋼鋼結構股份有限公司－新廠建置表現卓越
- 漢唐集成股份有限公司－新廠建置表現卓越

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2023 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 288 種製程技術，為 528 個客戶生產 1 萬 1,895 種不同產品。台積公司企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭

資深副總經理暨財務長

Tel: 886-3-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華

企業公共關係處主管

Tel: 886-3-563-6688 ext. 7125036

Mobile: 886-988-239-163

E-Mail: nina_kao@tsmc.com

連珮宇

企業公共關係處

Tel: 886-3-5636688 ext.7125033

Mobile : 886-963-854-707

E-Mail : pylien@tsmc.com